

湖北鼎龙控股股份有限公司

关于 2021 年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北鼎龙化学股份有限公司向王敏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]949号）核准，向不超过5名特定投资者发行46,345,100股，以募集配套资金。公司于2017年1月18日已按照21.38元/股的价格，完成向三名特定投资者非公开发行46,345,100股股份并募集资金990,858,238元，扣除各项发行费用19,300,000元后的实际募集资金净额为971,558,238元。上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字【2017】第2-0006号的《验资报告》。

本报告期，募集项目投入金额合计为2,389.34万元。截止2021年6月30日，专项账户余额合计为10,197.82万元（含利息收入），截止本报告披露日，募集资金账户余额已补充流动金额，募集资金账户已销户。

二、募集资金管理情况

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及上市公司制定的募集资金管理制度中相关条款的规定，公司已分别在中信银行武汉分行，浙商银行武汉分行，招商银行武汉循礼门支行开设募集资金专户。2017年1月18日公司分别与中信银行武汉分行，浙商银行武汉分行，招商银行武汉循礼门支行及独立财务顾问西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）签订了《募集资金三方监管协议》。2017年9月2日为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司和湖北鼎汇微电子材料有限公司、中信银行股份有限公司武汉分行以及西南证券股份有限公司签署了《募集资金专户管理三方协议》。2018年3月7日为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司及其下属子公司：珠海联合天润打印耗材有限公司、武汉柔显科技股份有限公司、杭州旗捷科技有限公司和西南证券股份有限公司分别和中国民生银行股份有限公司珠海分行、招商银行股份有限公司武汉循礼门支行、杭州银行股份有限公司科技支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。上述专项账户仅用于所募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2021年上半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2017年2月10日，第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金6,000.00万元置换截至2017年1月20日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。本次置换已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）核准并出具大信专审字【2017】第2-00054号报告，独立董事和保荐机构均对本次置换发表了同意意见。

(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(五)节余募集资金使用情况

本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

(六)超募资金使用情况

本公司不存在超募资金使用情况。

(七)尚未使用的募集资金用途及去向

2021年4月8日和2021年5月7日，公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议和2020年度股东大会相继审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并永久性补充流动资金的议案》，同意终止原“打印耗材试验研发基地建设项目”、“集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发中心项目”和“年产800万支通用再生耗材智能化技术改造项目”，并将剩余10,607.01万元募集资金（包括公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理取得的理财收益及募集资金专户活期利息收入）永久补充流动资金（实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准）。

截至本公告披露日，该次终止部分非公开发行募投项目并永久性补充流动资金事项已完

成，实际补充流动资金10,197.82万元。

(八)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

(一)变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

(二)未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况

1、年产800万支通用再生耗材智能化技术改造项目

本项目实施的主要目的是以满足市场需求，提升名图彩色再生硒鼓生产线的智能化和自动化水平。鉴于目前公司在该项目主体之外以新设控股子公司为实施主体，正在建设多条硒鼓全自动化产线，且部分硒鼓半自动化产线已经投产，经审慎研究，决定终止该项目。

2、集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发中心项目

本项目实施的主要目的为开展CMP材料、芯片保护胶带、湿电子化学品的研发，突破制造工艺材料和柔性显示新材料研发垄断壁垒，致力于CMP抛光材料、CMP后清洗液、芯片保护胶带、柔性OLED用聚酰亚胺的产业化。鉴于现阶段公司用于集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发的设备购置及产线安装已经分别在鼎汇微电子和柔显科技两个控股子公司主体上完成，相关材料的研发已取得进展或正在推进，且拟新建潜江产业园进行抛光垫三期及清洗液的产业化，发展计划有所调整，经审慎研究，决定终止该项目。

3、打印耗材试验研发基地建设项目

本项目实施的主要目的为对打印耗材行业产品关键技术突破及前沿技术研究开发，加快公司现有技术的产业化速度。鉴于公司现阶段的主要研究方向在光电半导体及柔性显示新材料领域，且公司在耗材领域拥有竞争优势，技术领先于行业平均水平，经审慎研究，决定终止该项目。

(三)变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益情况。

(四)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、其他需要说明的事项

无

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

湖北鼎龙控股股份有限公司董事会

2021年8月19日

附表 1:

募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额		97,155.82				本年度投入募集资金总额		12,587.16		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额		101,853.03		
累计变更用途的募集资金总额		33,040.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		34.01%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目:										
彩色打印复印通用耗材研发中心项目	是	5,000.00					2017年12月31日		不适用	是
品牌营销网络及技术支持中心项目	是	8,040.00					2019年6月30日		不适用	是
集成电路(IC)芯片及制程工艺材料研发中心项目	是	20,000.00	484.85		484.85	100%	2018年6月30日		不适用	是
集成电路芯片(IC)抛光工艺材料的产业化二期项目	否	7,600.00	7,600.00		7,923.12	104.25%	2018年12月31日		不适用	否
集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发中心项目	是		3,905.85	591.31	3,495.09	89.48%	2019年12月31日		不适用	否
柔性显示基板材料研发及产业化项目	是		3,000.00		3,027.78	100.93%	2020年6月30日		不适用	否

打印耗材试验研发基地建设 项目	是		12,000.00	1,798.03	8,343.47	69.53%	2019年12月31日		不适用	否
年产800万支通用再生耗材智能化技术改造 项目	是		4,000.00		410.65	10.27%	2018年12月31日		不适用	否
旗捷智能打印耗材芯片研发中心升级改造 项目	是		10,000.00		10,356.37	103.56%	2019年12月31日		不适用	否
重组交易的现金对价款	否	23,672.90	23,672.90		23,672.90	100.00%	2017年12月31日		不适用	不适用
补充流动资金	否	32,842.92	32,842.92	10,197.82	44,138.80	134.39%	2019年12月31日		不适用	不适用
承诺投资项目小计	--	97,155.82	97,506.52	12,587.16	101,853.03	--	--			
未达到计划进度原因（分具体项目）	<p>1、年产800万支通用再生耗材智能化技术改造项目 本项目实施的主要目的是以满足市场需求，提升名图彩色再生硒鼓生产线的智能化和自动化水平。鉴于目前公司在该项目主体之外以新设控股子公司为实施主体，正在建设多条硒鼓全自动化产线，且部分硒鼓半自动化产线已经投产，经审慎研究，决定终止该项目。</p> <p>2、集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发中心项目 本项目实施的主要目的为开展CMP材料、芯片保护胶带、湿电子化学品的研发，突破制造工艺材料和柔性显示新材料研发壁垒，致力于CMP抛光材料、CMP后清洗液、芯片保护胶带、柔性OLED用聚酰亚胺的产业化。鉴于现阶段公司用于集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发的设备购置及产线安装已经分别在鼎汇微电子和柔显科技两个控股子公司主体上完成，相关材料的研发已取得进展或正在推进，且拟新建潜江产业园进行抛光垫三期及清洗液的产业化，发展计划有所调整，经审慎研究，决定终止该项目。</p> <p>3、打印耗材试验研发基地建设项目 本项目实施的主要目的为对打印耗材行业产品关键技术突破及前沿技术研究开发，加快公司现有技术的产业化速度。鉴于公司现阶段的主要研究方向在光电半导体及柔性显示新材料领域，且公司在耗材领域拥有竞争优势，技术领先于行业平均水平，经审慎研究，决定终止该项目。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	因公司的发展计划调整，公司决定终止年产800万支通用再生耗材智能化技术改造项目、集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发中心项目、打印耗材试验研发基地建设项目，并将剩余募集资金补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	2018年1月17日和2018年2月6日，公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议和2018年第一次临时股东大会相继审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》，独立董事对该事项发表了独立意见，独立财务顾问西南证券股份有限公司对公司本次变更部分募集资金使用用途事项无异议。募集资金变更后的将全部用于年产800万支通用再生耗材智能化技术改造项目、集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发中心项目、柔性显示基板材料研发及产业化项目、打印耗材试验研发基地建设项目、旗捷智能打印耗材芯片研发中心升级改造项目，拟投入募集配套资金分别为4,000.00万元、3,905.85万元、3,000.00万元、12,000.00万元、10,000.00万元。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2017年2月10日，第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金6,000.00万元置换截至2017年1月20日预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。本次置换已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）核准并出具大信专审字【2017】第2-00054号报告，独立董事和保荐机构均对本次置换发表了同意意见。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2021年4月8日和2021年5月7日，公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议和2020年度股东大会相继审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并永久性补充流动资金的议案》，同意终止原“打印耗材试验研发基地建设项目”、“集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发中心项目”和“年产800万支通用再生耗材智能化技术改造项目”，并将剩余10,607.01万元募集资金（包括公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理取得的理财收益及募集资金专户活期利息收入）永久补充流动资金（实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准）。 截至本公告披露日，该次终止部分非公开发行募投项目并永久性补充流动资金事项已完成，实际补充流动资金10,197.82万元。
募集资金其他使用情况	不适用

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位:湖北鼎龙控股股份有限公司

2021 年上半年度

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发中心项目	集成电路(IC)芯片及制程工艺材料研发中心项目	3,905.85	591.31	3,495.09	89.48%	2019年12月31日		不适用	否
柔性显示基板材料研发及产业化项目	品牌营销网络及技术支持中心项目	3,000.00		3,027.78	100.93%	2020年6月30日		不适用	否
打印耗材试验研发基地建设项目	彩色打印复印通用耗材研发中心项目	12,000.00	1,798.03	8,343.47	69.53%	2019年12月31日		不适用	否
年产 800 万支通用再生耗材智能化技术改造项目	彩色打印复印通用耗材研发中心项目	4,000.00		410.65	10.27%	2018年12月31日		不适用	否
旗捷智能打印耗材芯片研发中心升级改造项目	集成电路芯片(IC)抛光工艺材料产业化二期项目	10,000.00		10,356.37	103.56%	2019年12月31日		不适用	否
合计		32,905.85	2,389.34	25,633.36	--				
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>一、变更原因</p> <p>本次募集资金投向的变更,主要是根据公司目前产业战略方向、打印复印耗材业务发展情况和湖北省芯片产业及柔性显示产业的布局,细化和调整了募投项目“集成电路(IC)芯片及制程工艺材料研发中心项目”和“彩色打印复印通用耗材研发中心项目”项目,取消了“品牌营销网络及技术支持中心项目”。</p> <p>二、决策程序</p> <p>2018年1月17日和2018年2月6日,公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议和2018年第一次临时股东大会相继审议通过了《关于变更部分募集资金使用用途的议案》,独立董事对该事项发表了独立意见,独立财务顾问西南证券股份有限公司对公司本次变更部分募集资金使用用途事项无异议。</p> <p>三、信息披露情况</p> <p>2018年1月18日和2018年2月7日,公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)分别披露了《第三届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2018-003)、《第三届监事会第二十次会议决议公告》(公告编号:2018-004)、《关于变更部分募集资金使用用途的公告》(公告编号:2018-005)及《2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-010)等相关公告。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、年产 800 万支通用再生耗材智能化技术改造项目</p> <p>本项目实施的主要目的是以满足市场需求,提升名图彩色再生硒鼓生产线的智能化和自动化水平。鉴于目前公司在该项目主体之外以新设控股子公司为实施主体,正在建设多条硒鼓全自动化产线,且部分硒鼓半自动化产线已经投产,经审慎研究,决定终止该项目。</p> <p>2、集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发中心项目</p> <p>本项目实施的主要目的为开展 CMP 材料、芯片保护胶带、湿电子化学品的研发,突破制造工艺材料和柔性显示新材料研发壁垒,致力于 CMP 抛光材料、CMP 后清洗液、芯片保护胶带、柔性 OLED 用聚酰亚胺的</p>								

	<p>产业化。鉴于现阶段公司用于集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发的设备购置及产线安装已经分别在鼎汇微电子和柔显科技两个控股子公司主体上完成，相关材料的研发已取得进展或正在推进，且拟新建潜江产业园进行抛光垫三期及清洗液的产业化，发展计划有所调整，经审慎研究，决定终止该项目。</p> <p>3、打印耗材试验研发基地建设项目</p> <p>本项目实施的主要目的为对打印耗材行业产品关键技术突破及前沿技术研究开发，加快公司现有技术的产业化速度。鉴于公司现阶段的主要研究方向在光电半导体及柔性显示新材料领域，且公司在耗材领域拥有竞争优势，技术领先于行业平均水平，经审慎研究，决定终止该项目。</p>
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	因公司的发展计划调整，公司决定终止年产 800 万支通用再生耗材智能化技术改造项目、集成电路制程工艺材料及柔性显示材料研发中心项目、打印耗材试验研发基地建设项目，并将剩余募集资金补充流动资金。

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。